

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. F., Yefta, R. P., & Endarko. (2016). Karakteristik Dioda (E9). *Jurnal Elektronika Dasar Ii*, 1114100089, 1–5.
- Anggoro, S., Nurisna, Z., Safitri, M., & Pratama, A. W. (2021). Analisis Sistem Kelistrikan Body pada Sepeda Motor Suzuki Nex-FI. *Quantum Teknika : Jurnal Teknik Mesin Terapan*, 2(2), 75–79. <https://doi.org/10.18196/jqt.v2i2.10693>
- Augustin, A., Rajendra Udupa, K., & Udaya Bhat, K. (2016). Effect of coating current density on the wettability of electrodeposited copper thin film on aluminum substrate. *Perspectives in Science*, 8, 472–474. <https://doi.org/10.1016/j.pisc.2016.06.003>
- Bambang Santosa, & Martijanti Syamsa. (2007). Pengaruh Parameter Proses Pelapisan Nikel Terhadap Ketebalan Lapisan. *Jurnal Teknik Mesin*, 9(1), 25–30. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/mes/article/view/16642>
- Basmal, Bayuseno, & Nugroho, S. (2012). Pengaruh Suhu dan Waktu Pelapisan Tembaga-Nikel pada Baja Karbon Rendah Secara Elektroplating Terhadap Nilai Ketebalan dan Kekerasan. *Rotasi*, 14(2), 23–28. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/rotasi/article/view/4634>
- Bayuseno, A., & Nugroho, S. (2012). *Pengaruh konsentrasi larutan dan kuat arus terhadap ketebalan pada proses pelapisan nikel untuk baja karbon rendah*. 1, 23–27. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/rotasi-23->
- Budiyanto, E., Setiawan, D. A., Supriadi, H., & Ridhuan, K. (2017). Pengaruh Jarak Anoda-Katoda Pada Proses Elektroplating Tembaga Terhadap Ketebalan Lapisan Dan Efisiensi Katoda Baja Aisi 1020. *Turbo : Jurnal Program Studi Teknik Mesin*, 5(1), 21–29. <https://doi.org/10.24127/trb.v5i1.115>
- Guang, Y., Ying, D., Sheng, Y., Yiyong, F., Jun, W., Shuqiang, G., & Rong, J. (2019). Early Doppler ultrasound in the superior mesenteric artery and the prediction of necrotizing enterocolitis in preterm neonates. *Journal of*

Ultrasound in Medicine, 38(12), 3283–3289.

Han, K. H., Lee, S. B., & Hong, I. K. (2012). Barrel plating process specification for undercoating with copper cyanate. *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 18(3), 888–897. <https://doi.org/10.1016/j.jiec.2011.11.066>

Kaban, H., Niar, S., & Jorena, D. (2010). Menguji Kekuatan Bahan Elektroplating Pelapisan Nikel pada Substrat Besi dengan Uji Impak (Impact Test). *Jurnal Penelitian Sains*, 13, 13305.

Kognisi, P. K., Risiko, P., Jenis, D. A. N., Bidori, F., Puspitowati, L. I. dan I., Wijaya, I. G. B., Alifah, U., Artikel, I., Paedagoria, S. N., Anwar, I., Jamal, M. T., Saleem, I., Thoudam, P., Hassan, A., Anwar, I., Saleem, I., Islam, K. M. B., Hussain, S. A., Witcher, B. J., ... alma. (2021). Studi Electrochemical Analysis Lantanum (III) Klorida Heptahidrat 98% Di bawah Pengaruh Medan Magnet Dan Pengaplikasiannya Sebagai Aditif Magneto Elektrodeposisi Logam Krom. *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689–1699. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspac.e.uc.ac.id/handle/123456789/1288>

Lou, H. H. (2006). Electroplating. *Electroplating*, 1–10. <https://doi.org/10.1081/E-ECHP-120007747>

Mauna, R. B., Ma, I., & Nigrum, P. T. (2015). Kandungan Kromium (Cr) pada Limbah Cair dan Air Sungai serta Keluhan Kesehatan Masyarakat di Sekitar Industri Elektroplating. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 0–5. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68964>

Nafis, M. F., Widodo, T., Riyadi, B., Sugito, B., & Partono, P. (2022). *Keilmuan dan Keislaman Pelapisan Cu/Ni pada Bahan Aluminium dengan Metode Elektroplating Histori Artikel*. 33–41.

Niam, M. Y., Purwanto, H., & Respati, S. M. B. (2017). Pengaruh Waktu Pelapisan Elektro Nikel-Khrom Dekoratif Terhadap Ketebalan, Kekerasan dan Kekerasan Lapisan. *Momentum*, 13(1), 7–10.

Octavia, C. K. A. B. (2019). Efektivitas kulit kacang tanah (*Arachis hypogaea* L.)

sebagai bioadsorben logam berat kromium vi pada limbah industri pelapisan logam krom. *Skripsi, Program Studi Kesehatan Lingkungan, Stikes Widyagama Husada, Malang.*

Rethinam, J., Sriveeraraghavan, S., Jayakrishnan, S., Sethumadhavan, S., Ramesh, S., Sriram, V., & Krishnan, R. M. (1996). Electroplating of Nickel Using a Modified Barrel Design. *Transactions of the IMF*, 74(5), 179–181. <https://doi.org/10.1080/00202967.1996.11871122>

Sebastyantito, A. (2019). *Waktu Proses Elektroplating Kuningan Pada Baja Karbon Rendah Terhadap Daya Lekat, Ketebalan, Dan Kekilauan Hasil Pelapisan.*

Setianingrum, N. P., Prasetya, A., & Sarto, S. (2018). Pengurangan Zat Warna Remazol Red Rb Menggunakan Metode Elektrokoagulasi Secara Batch. *Jurnal Rekayasa Proses*, 11(2), 78. <https://doi.org/10.22146/jrekpros.26900>

Setiawan, H. (2014). Pengujian Kekerasan Dan Komposisi Kimia Produk Cor Propeler Alumunium. *Prosiding SNST Semarang*, 4(6), 31–36.

Suarsana I Ketut. (2008). Pengaruh waktu pelapisan nikel pada tembaga dalam pelapisan khrom dekoratif terhadap tingkat kecerahan dan ketebalan lapisan I Ketut Suarsana. *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin CAKRAM*, 2(1), 48–60.

Sudana, I. M., Arsani, I. A. A., & Waisnawa, I. G. . S. (2014). Alat Simulasi Pelapisan Logam dengan Metode Elektroplating. *Jurnal Logic*, 14(3), 190–198.

Sunardi, N. N. A. (2021). *Analisis Laju Korosi Pelapisan Logam Besi oleh Nikel di Lingkungan Air Laut Ninik Nigusti Ayu Sunardi Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan Abstrak Logam besi adalah logam yang sering ditemukan dalam berbagai komponen kendaraan dan mesin . July 2021.*

Sundaram, R., Yamada, T., Hata, K., & Sekiguchi, A. (2017). The influence of Cu electrodeposition parameters on fabricating structurally uniform CNT-Cu composite wires. *Materials Today Communications*, 13(September), 119–125. <https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2017.09.003>

Syamsuir, Fajar, H., Widodo, K., & Sopiyan. (2019). *Terhadap Laju Korosi Program Studi Teknik Mesin , Fakultas Teknik , Universitas Negeri Jakarta Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin , Fakultas Teknik , Universitas Negeri Jakarta. April, 44–48.*

Syamsuir, Kusumah, R. S., Premono, A., Lubi, A., Soegijono, B., Yudanto, S. D., Ajiriyanto, M. K., Ismarwanti, S., Kriswarini, R., Rosyidan, C., Nanto, D., Basori, & Susetyo, F. B. (2024). Spinning Effect of Barreling Plating on Physical Properties and Electrochemical Behavior of Copper Layers. *E-Journal of Surface Science and Nanotechnology*, 22(2), 120–128. <https://doi.org/10.1380/ejssnt.2024-003>

